

**NORME
INTERNATIONALE**

**CEI
IEC**

**INTERNATIONAL
STANDARD**

60747-9

Première édition
First edition
1998-08

**Dispositifs à semiconducteurs –
Dispositifs discrets –**

**Partie 9:
Transistors bipolaires à grille isolée (IGBT)**

**Semiconductor devices –
Discrete devices –**

**Part 9:
Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs)**

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

| | Pages |
|---|-------|
| AVANT-PROPOS | 4 |
| INTRODUCTION | 6 |
| Articles | |
| 1 Domaine d'application | 8 |
| 2 Références normatives..... | 8 |
| 3 Définitions..... | 8 |
| 3.1 Termes généraux..... | 8 |
| 3.2 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques; tensions et courants.. | 10 |
| 3.3 Termes relatifs aux valeurs limites et caractéristiques; autres caractéristiques.... | 12 |
| 4 Symboles littéraux..... | 14 |
| 4.1 Généralités | 14 |
| 4.2 Autres indices généraux..... | 14 |
| 4.3 Liste des symboles littéraux | 14 |
| 5 Valeurs limites et caractéristiques essentielles | 18 |
| 5.1 Généralités | 18 |
| 5.2 Conditions pour les valeurs limites | 18 |
| 5.3 Valeurs limites | 18 |
| 5.4 Caractéristiques..... | 20 |
| 6 Méthodes de mesure..... | 26 |
| 6.1 Généralités | 26 |
| 6.2 Méthodes de mesure..... | 28 |
| 7 Réception et fiabilité..... | 48 |
| Annexe A (informative) – Symbole graphique des transistors bipolaires à grille isolée proposé par le sous-comité 47E | 50 |

CONTENTS

| | Page |
|---|------|
| FOREWORD | 5 |
| INTRODUCTION | 7 |
| Clause | |
| 1 Scope | 9 |
| 2 Normative references | 9 |
| 3 Definitions..... | 9 |
| 3.1 General terms | 9 |
| 3.2 Terms related to ratings and characteristics; voltages and currents | 11 |
| 3.3 Terms related to ratings and characteristics; other characteristics | 13 |
| 4 Letter symbols..... | 15 |
| 4.1 General..... | 15 |
| 4.2 Additional general subscripts..... | 15 |
| 4.3 List of letter symbols | 15 |
| 5 Essential ratings and characteristics..... | 19 |
| 5.1 General..... | 19 |
| 5.2 Rating conditions | 19 |
| 5.3 Ratings (limiting values) | 19 |
| 5.4 Characteristics | 21 |
| 6 Methods of measurement..... | 27 |
| 6.1 General..... | 27 |
| 6.2 Measuring methods..... | 29 |
| 7 Acceptance and reliability | 49 |
| Annex A (informative) – Graphical symbol of IGBT proposed by subcommittee 47E | 51 |

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – DISPOSITIFS DISCRETS –

Partie 9: Transistors bipolaires à grille isolée (IGBT)

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60747-9 a été établie par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets à semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS | Rapport de vote |
|--------------|-----------------|
| 47E/109/FDIS | 47E/115/RVD |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La présente norme doit être lue conjointement avec la CEI 60747-1.

L'annexe A est donnée à titre d'information uniquement.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES – DISCRETE DEVICES –**Part 9: Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs)****FOREWORD**

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60747-9 has been prepared by subcommittee 47E: Discrete semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

| | |
|--------------|------------------|
| FDIS | Report on voting |
| 47E/109/FDIS | 47E/115/RVD |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This standard is to be read in conjunction with IEC 60747-1.

Annex A is for information only.

INTRODUCTION

L'utilisation des transistors bipolaires à grille isolée est exclusivement réservée aux applications de commutation de puissance. Leur utilisation dans le cadre de l'amplification proportionnelle n'est pas prévue car le courant collecteur augmente avec la température pour une tension de grille constante, ce qui provoquerait un emballement thermique dans cette application. Dans le cas d'une application de commutation, le courant collecteur au cours des intervalles à l'état passant est indiqué par la tension d'alimentation et la caractéristique de charge, et la contrainte exercée sur le transistor bipolaire à grille isolée est contrôlée par la durée d'impulsion et la fréquence de répétition.

L'utilisateur trouvera dans la CEI 60747-1 toutes les informations de base concernant les points suivants:

- terminologie;
- symboles littéraux;
- valeurs limites et caractéristiques essentielles;
- méthodes de mesure;
- réception et fiabilité;
- dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques.

INTRODUCTION

IGBTs are in use exclusively in power switching applications. Their use for proportional amplification is not provided because the collector current rises with temperature at constant gate voltage which would cause thermal runaway in this application. In switching applications the collector current during the on-state intervals is given by the supply voltage and the load characteristic, and the stress on the IGBT is controlled by the pulse duration and repetition frequency.

In IEC 60747-1 the user will find all basic information on:

- terminology;
- letter symbols;
- essential ratings and characteristics;
- measuring methods;
- acceptance and reliability;
- electrostatic-sensitive devices.

Withdrawn

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – DISPOSITIFS DISCRETS –

Partie 9: Transistors bipolaires à grille isolée (IGBT)

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60747 spécifie la terminologie, les symboles littéraux, les valeurs limites et caractéristiques essentielles ainsi que les méthodes de mesure pour les transistors bipolaires à grille isolée.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60747. Au moment de sa publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 60747 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60617-5:1996, *Symboles graphiques pour schémas – Partie 5: Semiconducteurs et tubes électroniques*

CEI 60747-1:1983, *Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets et circuits intégrés – Partie 1: Généralités*

CEI 60747-2:1983, *Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs discrets et circuits intégrés – Partie 2: Diodes de redressement*

SEMICONDUCTOR DEVICES – DISCRETE DEVICES –**Part 9: Insulated-gate bipolar transistors (IGBTs)****1 Scope**

This part of IEC 60747 gives product specific standards for terminology, letter symbols, essential ratings and characteristics and measuring methods for insulated-gate bipolar transistors (IGBTs).

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 60747. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 60747 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60617-5:1996, *Graphical symbols for diagrams – Part 5: Semiconductors and electron tubes*

IEC 60747-1:1983, *Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 1: General*

IEC 60747-2:1983, *Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 2: Rectifier diodes*